

广州广合科技股份有限公司

关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买土地使用权需要通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

2、云擎智造基地项目（以下简称“本项目”）投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。

3、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照预计期限完成存在不确定性。

4、本项目提及的投资金额、投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述

为把握行业发展机遇，扩大优势产品产能，提升智能制造水平，根据公司中长期战略发展规划，公司拟通过招拍挂方式购买广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）出让的位于广州市黄埔区东江大道以东的土地使用权并投资建设云擎智造基地项目。本项目投资金额约 26 亿元人民币

（含购买土地使用权款），公司将以自有资金、银行贷款或其他融资方式出资，用于项目的开发和运营。

上述事项已经公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，具体投资额度和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。同意公司经营管理层就上述事项办理与当地政府签协议、土地摘牌、项目建设、环评等与本事项相关的一切手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟购买土地使用权的基本情况

1、地块编号：GZG-G-1

2、地块位置：广州市黄埔区东江大道以东

3、用地性质：二类工业用地（M2）

4、总用地面积：27,452.50 平方米

其中：可建设用地面积 25,349.37 平方米，绿地用地面积 2,103.13 平方米。

5、土地出让年限：50 年

6、竞拍起始价：4,132 万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准）

本次拟购买土地使用权的出让方为广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局），交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

注：地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准。

三、拟投资新建项目的基本情况

1、项目名称：云擎智造基地项目（具体名称以项目备案名称为准）

2、项目实施主体：广州广合科技股份有限公司

3、项目投资规模：约 26 亿元人民币（含购买土地使用权款，具体以实际投资金额为准）。经初步测算，本次扩产投资项目税后回收期约为 6.5 年（含建设期）。

4、建设时间：本次投资建设项目周期为 2025 年下半年至 2027 年。

5、项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。

6、项目必要性和可行性分析：

（1）顺应客户需求，满足市场需求的快速增长

随着全球服务器云厂商资本开支持续高增长，市场对 AI 算力的需求也将持续增长，进而将带动 AI 服务器市场的高景气度延续，叠加人工智能的快速迭代和应用深化，也将驱动 PCB 产品性能向更高水平演进，市场对高层数、高精度、高密度、高可靠性 PCB 产品的需求将持续增长。据 Prismark2024 年第四季度报告预测，2025 年全球 PCB 产业以美元计价的产值将达到 785.62 亿美元，同比增加 6.8%，预计 HDI 板和 18 层及以上的高多层板等高端产品仍将保持相对较高的增速，2024 年至 2029 年复合增速分别为 6.40%、15.70%。

经过公司多年的技术积累与发展，公司具备 46 层高多层板的量产能力并完成 7 阶 HDI 制造工艺的验证。随着与客户合作的广度和深度不断增强，基于广州工厂现有的订单负荷及物理空间限制，无法满足所有客户高多层 PCB 和 HDI 等高端 PCB 产品的需求。因此，本项目的实施将进一步扩大公司高端 PCB 业务规模，优化产品结构，增强公司的综合实力。

（2）提升公司核心竞争力，巩固市场地位

公司作为国内领先的服务器 PCB 供应商，凭借技术研发、工程设计、生产制造、品质管控等方面的显著优势，在原材料采购、标准化作业、柔性化生产、信息化管理、信赖性检测等方面持续打造出具有竞争力的产品供应能力，并连续多年入选中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国 PCB 百强企业。PCB 行业正面临良好的发展空间及快速增长的市场需求，而 PCB 企业数量众多，公司亦面临较大的竞争压力。因此，为了在激烈的市场竞争中抓住相关产业的发展机遇，巩固并提高公司在国内外 PCB 市场的地位，公司亟需在技术实力、经营规模、生产能力等方面进行全方位提升。通过本项目建设，公司将扩大高端印制电路板的生产能力，满足服务器应用领域客户的需求，提升核心产品的竞争力，巩固公司的市场地位。

（3）公司多年的生产运营经验为本项目实施提供经验保障

公司具备成熟的工艺、技术及丰富的生产经验，为项目顺利实施奠定了良好的基础。在工艺技术方面，公司不断推动生产线技改升级，积极引进智能自动化设备提高生产效率和水平，使各项设备技术能力已处于行业内的领先水平，确保人、机、料等生产成本受到严格把控。在生产经验方面，公司依托现有生产工艺流程，与工程技术、研究、品质、供应链等多部门紧密配合高效协同运作，并制定严格的生产考核制度和质量控制体系保障生产的顺利实施。形成了一支优秀的技术研发、市场开发、生产管理、供应链管理的人才队伍，确保运营管理高效运作。

公司不仅在广州工厂长期经营中积累了成熟的运营管理经验，在黄石工厂和泰国工厂筹备、建设、投产过程中也获取了丰富的新线筹备工作经验，能够为本次项目的建设、生产及运营管理提供丰富的实践经验，确保本项目顺利实施。

（4）强大的自主研发能力为项目实施提供技术支撑

公司多年来专注于印制电路板的研发、生产和销售，形成了以服务器为主，涵盖消费电子、工业控制、通信、汽车电子、安防电子等应用领域的 PCB 产品系列。公司深耕行业多年，一直保持较高的技术研发投入，每年将营业收入的 4%~5% 作为研究开发支出，充足的研发资金投入提高了项目产出量，为公司的技术研究提供了资金保障。公司还积极鼓励研究团队开展研究项目，不断提升生产工艺、

技术水平，同时公司还十分重视技术工艺和新材料的研究与应用。

公司围绕算力产品，从材料、工艺、产品、加工方法等领域持续研发投入，取得丰硕成果，截至 2024 年 12 月 31 日，累计申请专利 418 项，获得专利授权 210 项；主持和参与行业/团体标准制定 13 项。在高多层 PCB 及高阶 HDI 类 PCB 产品持续取得技术突破，并获得客户认可。

（5）稳定客户资源为项目实施提供市场保障

经过多年的市场拓展，公司主要客户涵盖国内外知名服务器厂商和 EMS 企业，公司凭借其先进的技术、优质的产品、快速响应的服务以及丰富的行业经验，受到下游客户的广泛认可，并与客户建立了长久、稳定的合作关系和积极的沟通反馈机制，双方达成了合作共赢的商业模式。

公司不仅在核心产品领域具备稳定、优质的客户资源，还能持续挖掘客户需求建立更多合作关系，公司的客户开拓与关系维护能力能够为本项目的实施提供可靠的市场保障，为新项目产能消化提供市场资源。

四、本次投资对公司的影响

本项目符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局，有利于公司的长期和持续发展，进一步提升高端印制电路板产能，满足客户市场需求，增强市场竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，为公司未来持续发展奠定坚实基础，符合公司全体股东的利益。

五、本次投资的风险分析及应对

1、公司本次拟购买土地使用权需要通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。公司将积极与地方政府、有关部门保持有效沟通，做好相关工作，进一步保障本项目的各项审批工作有序推进。

2、本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。

3、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照预计期限完成存在不确定性。公司将在国家各项政策和产业政策指导下，加强内部管理，提高经营效率，降低营运成本，增强抵御政策风险的能力。

4、本项目提及的投资金额、投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第四次会议决议。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日